

Ausbildungsplan Sachliche und zeitliche Gliederung der Ausbildung Anlage zum Berufsausbildungsvertrag

	Datum der Unterzeichnung
Ausbildungsbetrieb (Ausbildender):	
Auszubildende/r:	
Ausbildungsberuf:	Mikrotechnologe/-in
	Schwerpunkt: Halbleitertechnik
	□ Mikrosystemtechnik

Die sachliche und zeitliche Gliederung der zu vermittelnden Kenntnisse und Fertigkeiten laut der **Ausbildungsverordnung vom 06. März 1998** ist in den folgenden Seiten niedergelegt. Der zeitliche Anteil des gesetzlichen bzw. tariflichen Urlaubsanspruches, des Berufsschulunterrichtes und der Zwischen- und Abschlussprüfung des Auszubildenden ist in den einzelnen zeitlichen Richtwerten enthalten. Änderungen des Zeitumfanges und des zeitlichen Ablaufes aus betrieblich oder schulisch bedingten Gründen oder aus Gründen in der Person des Auszubildenden bleiben vorbehalten.

Abschnitt 1: Gemeinsame Ausbildungsinhalte

			7 . '11' . 1	D: 1.1	
			Zeitliche Richtwerte in		
Lfd.	Teil des	Fertigkeiten und Kenntnisse, die unter Einbeziehung selbstständigen Planens, Durchführens und Kontrollierens zu vermitteln sind		Wochen im	
Nr.	Ausbildungsberufsbildes			bildungsjahr	
			1	2 und 3	
1	Berufsbildung, Arbeits-	a) Bedeutung des Ausbildungsvertrages, insbesondere Abschluss,			
	und Tarifrecht	Dauer und Beendigung, erklären			
	(§ 3 Nr.1)	b) gegenseitige Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag			
	,	nennen			
		c) Möglichkeiten der beruflichen Fortbildung nennen			
		d) wesentliche Teile des Arbeitsvertrages nennen			
		e) wesentliche Bestimmungen der für den ausbildenden Betrieb			
		geltenden Tarifverträge nennen			
2	Aufbau und Organisation	a) Aufbau und Aufgaben des ausbildenden Betriebes erläutern			
	des Ausbildungsbetrie-	b) Grundfunktionen des ausbildenden Betriebes, wie Beschaffung,			
	bes	Fertigung, Absatz und Verwaltung, erklären			
	(§ 3 Nr.2)	c) Beziehungen des ausbildenden Betriebes und seiner Beschäftig-			
	(3 -)	ten zu Wirtschaftsorganisationen, Berufsvertretungen und Ge-			
		werkschaften nennen			
		d) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweisen der betriebsverfas-			
		sungs- und personalvertretungs-rechtlichen Organe des ausbil-			
		denden Betriebes beschreiben			
3	Sicherheit und Gesund-	a) Gefährdung von Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz fest-	W	ährend der	
	heitsschutz bei der	stellen und Maßnahmen zu ihrer Vermeidung ergreifen	(gesamten	
	Arbeit	b) berufsbezogene Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften	Au	sbildung zu	
	(§ 3 Nr.3)	anwenden		vermitteln	
	,	c) Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben sowie erste Maß-			
		nahmen einleiten			
		d) Vorschriften des vorbeugenden Brandschutzes anwenden; Ver-			
		haltensweisen bei Bränden beschreiben und Maßnahmen zur			
		Brandbekämpfung ergreifen			
4	Umweltschutz	Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen im berufli-			
	(§ 3 Nr.4)	chen Einwirkungsbereich beitragen, insbesondere			
		a) mögliche Umweltbelastungen durch den Ausbildungsbetrieb und			
		seinen Beitrag zum Umweltschutz an Beispielen erklären			
		b) für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen des Umwelt-			
		schutzes anwenden			
		c) Möglichkeiten der wirtschaftlichen und umweltschonenden Ener-			
		gie- und Materialverwendung nutzen			
		d) Abfälle vermeiden; Stoffe und Materialien einer umweltschonen-			
		den Entsorgung zuführen			

Lfd. Nr.	Teil des Ausbildungsberufsbildes	1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Zeitliche Richtwerte in Wochen im Ausbildungsjahr	
			1	2 und 3
5	Anwenden technischer Unterlagen (§ 3 Nr.5)	a) Betriebs- und Gebrauchsanleitungen, Montage- und Wartungs- pläne, Zeichnungen, Fließbilder und Schaltungsunterlagen in deutscher und englischer Sparache lesen und anwenden	4	
		 b) Informationsquellen, insbesondere Dokumentationen, Handbücher, Fachberichte und Firmenunterlagen, in deutscher und englischer Sprache lesen und auswerten c) berufsbezogene nationale und europäische Vorschriften sowie technische Regelwerke lesen, auswerten und anwenden 		4
6	Planen und Organisieren der Arbeit (§ 3 Nr.6)	 a) Arbeitsplatz unter Berücksichtigung betrieblicher Vorgaben und ergonomischer Regeln einrichten b) Materialien, Ersatzteile, Werkzeuge sowie Betriebsmittel auswählen, lagern, disponieren und bereitstellen c) Geräte und technische Einrichtungen betriebsbereit machen, warten und überprüfen, bei Störungen Maßnahmen zu deren Beseitigung einleiten d) Arbeitsschritte festlegen und erforderliche Abwicklungszeiten einschätzen 	6	
		 e) Arbeitsabläufe und Teilaufgaben unter Beachtung wirtschaftlicher und terminlicher Vorgaben planen, bei Abweichungen von der Planung Prioritäten setzen f) Probleme analysieren und als Aufgabe definieren, Lösungsalternativen entwickeln und beurteilen g) Möglichkeiten zur Verbesserung der Arbeitsabläufe und Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Funktionsbereichen des Ausbildungsbetriebes erkennen sowie Vorschläge zur Verbesserung von Arbeitsvorgängen machen h) innerhalb der Gruppe Personaleinsatz und Arbeitsaufgaben organisieren und koordinieren i) Gesprächs- und Moderationstechniken sowie Präsentationstechniken anwenden 		6
7	Dokumentieren der Arbeiten, Bedienen von Datenverarbeitungsanlagen, Datenschutz (§ 3 Nr.7)	 a) Standardsoftware, insbesondere Textverarbeitungs-, Tabellenkal-kulations-, Grafik- und Planungssoftware, anwenden b) Statistiken führen und interpretieren c) Fertigungsdaten abrufen, eingeben und sichern d) Daten für die betriebliche Kostenrechnung dokumentieren e) Schriftverkehr und Berechnungen durchführen, Protokolle anfertigen, Daten und Sachverhalte visualderen, Grafiken erstellen 	4	4
8	Qualitätsmanagement (§ 3 Nr.8)	f)Vorschriften zum Datenschutz anwenden a) Prozesse überwachen und protokollieren, Messungen und Endkontrollen durchführen	4	
		 b) Arbeitsergebnisse zusammenführen, kontrollieren und unter Berücksichtigung betrieblicher Kostenzusammenhänge berwerten c) Zielerreichung kontrollieren, Qualitätsmanagementmaßnahmen durchführen, Qualitätskontrollen und technische Prüfungen dokumentieren d) Messergebnisse mit Werkzeugen der statistischen Qualitätskontrolle auswerten e) Einflüsse auf die Produktqualität ermitteln sowie Vorschläge zur Verbesserung machen 		8
9	Bereitstellen und Entsorgen von Arbeitsstoffen (§ 3 Nr.9)	 a) Arbeitsstoffe kennzeichnen, nach logistischen Haltbarkeits-, Sicherheits-, Qualitäts- und Umweltkriterien den Vorschriften entsprechend lagern, bereitstellen und auf Einsatzfähigkeit prüfen b) Laborgeräte zum Handhaben von Arbeitsstoffen auswählen und einsetzen c) gasförmige Arbeitsstoffe handhaben, insbesondere Gase entnehmen, Drücke messen d) Detektionsverfahren für Gase anwenden e) Chemikalien handhaben sowie Lösungen, insbesondere Ätzlösungen und fotochemische Lösungen nach Konzentrationsvorgaben herstellen f) Arbeitsstoffe insbesondere Gase und Chemikalien entsorgen g) Reinheit der Arbeitsstoffe sicherstellen, Verunreinigungen ver- 	15	2
10	Sichern und Prüfen der Reinraumbedingungen (§ 3 Nr.10)	meiden, Prüfen und entfernen a) betriebliche Richtlinien bezüglich Reinraumkleidung und Verhalten im Reinraum einhalten b) elektrostatische Gefährdung von Bauelementen (ESD-Sicherheit) prüfen und dokumentieren, bei Abweichungen Maßnahmen zur Beseitigung einleiten	4	3

Lfd. Nr.	Teil des Ausbildungsberufsbildes	Fertigkeiten und Kenntnisse, die unter Einbeziehung selbstständigen Planens, Durchführens und Kontrollierens zu vermitteln sind		Zeitliche Richtwerte in Wochen im Ausbildungsjahr 1 2 und 3	
		 c) Funktion von Filtern prüfen sowie Partikelmessungen der Reinraumluft durchführen d) anhand der Produktqualität auf die Entstehung und Ausbreitung von Verunreinigungen schließen e) Qualität des Laminarstroms sowie die reinraumgerechte Anordnung von Anlagen, Geräten und Arbeitsplätzen kontrollieren, Aufstellungsvarianten für Geräte und Anlagen erarbeiten 	1	4	
11	Umrüsten, Prüfen und vorbeugendes Instand- halten von Produktions- einrichtungen (§ 3 Nr.11)	a) mechanische und elektrische Komponenten sowie DV-technische Einrichtungen an geänderte Prozessabläufe und unterschiedliche Produkte anpassen, insbesondere - mechanische Konstruktionsteile zerlegen und zusammenbauen - Rohre, Rohrleitungsteile, Schläuche, Ventile und Regler verbinden sowie auf Dichtigkeit und Funktion prüfen - Konfektionierte elektrische Leitungen befestigen und anschließen - Änderungen der Anlage dokumentieren b) elektrische Größen messen, Bauteile prüfen sowie Signale an Schnittstellen prüfen c) vakuumtechnische Einrichtungen prüfen d) Störungen in Anlagen und Prozesseinrichtungen feststellen, mel-	15		
		den sowie dem Instandsetzer beschreiben, insbesondere - Störungen in Messeinrichtungen auf Grund chemischer und physikalischer Einwirkungen feststellen - Einrichtungen zum Messen von Temperatur, Druck, Flüssigkeitsstand, Durchfluss, Volumen- und Massenstrom prüfen - Sensoren prüfen und justieren - Sicherheits- und Meldesysteme nach Prüfvorschriften kontrollieren, Prüfprotokolle anfertigen e) vorbeugende Instandhaltung unter Berücksichtigung spezifischer Produktionsbedingungen durchführen, Arbeitsgeräte und Anlagen reinigen		13	
12	Einstellen von Prozess- parametern (§ 3 Nr.12)	 a) Betriebswerte von Produktionseinrichtungen nach Anweisung, Schaltungs- und Prüfunterlagen sowie nach Datenblättern einstellen, abgleichen und prüfen b) Sollwerte von prozessrelevanten Größen, insbesondere Drehzahl, Temperatur-, Druck- und Durchflusssollwerte, einstellen c) Funktions- und Prozessablauf anhand technischer Unterlagen kontrollieren, prüfen, anpassen und dokumentieren 		4	
13	Optimieren des Produktionsprozesses (§ 3 Nr.13)	 a) Verbesserungsmöglichkeiten im Bereich Defektdichte, Durchlaufzeit, Qualität und Ausbeute feststellen b) Messergebnisse im Team analysieren und Verbesserungspotentiale diskutieren c) Prozessabläufe anhand von Ergebnissen prozssbegleitender Kontrollen nach Vorgaben verändern, Optimierung des Zusammenwirkens von Prozss und Anlage unterstützen d) beim Fertigungsablauf neuer oder veränderter Produkte mitwirken und eigene Erfahrungen zur Optimierung nutzen 		6	

Abschnitt 2: Ausbildungsinhalte in den Schwerpunkten Schwerpunkt: Halbleitertechnik

Lfd. Nr.	Teil des Ausbildungsberufsbildes	,	Zeitliche Richtwerte in Wochen im Ausbildungsjahr	
. 11.			1	2 und 3
14	Herstellungs- und Montageprozsse (§ 3 Nr.14)	Produktionsanlagen zur Herstellung von Halbleiterkomponenten bedienen und beschicken, Prozesse kontrollieren und überwachen, insbesondere a) Oberflächenbehandlungen durchführen, insbesondere dünnschleifen, chemisch-mechanisch polieren und tempern b) Strukturen durch Belacken, Belichten, Entwickeln und Ätzen erzeugen c) Schichten, insbesondere durch Oxidation, Gasabscheidung, Epitaxie, Aufdampfen und Sputtern, erzeugen d) Dotierprozesse durchführen e) nasschemische Prozesse, insbesondere Reinigungs- und Ätzprozesse, durchführen f) Wafer trennen g) Chips montieren, kontaktieren und häusen		18
15	Prozessbegleitende Prüfungen (§ 3 Nr.15)	 a) optische Identifizierung von Einzelkomponenten und Teilkompnenten integrierter Schaltungen auf Wafern durchführen, insbesondere von Widerständen, Dioden, Transistoren, Kondensatoren und Kontaktierungen b) Zusammenhänge zwischen den Eigenschaften mikrotechnischer Produkte sowie Prozessparametern, Prozessschritten und Strukturen beachten c) Partikelmessungen und Schräglichtkontrollen durchführen d) Justage und Maßhaltigkeit der Strukturen kontrollieren e) Schichtdicken optisch, elektrisch und mechanisch messen f) elektrische Kennwerte von Bauelementen anhand von Teststrukturen messen und prüfen g) anhand von Prüfungsergebnissen auf Prozessfehler und auf zu verändernde Prozessparameter schließen 		10
16	Durchführen von Endtests (§ 3 Nr.16)	a) Parametermessungen im Waferprüffeld durchführen b) elektrische Funktionsanalyse, insbesondere unter Dauerbelastung, wechselndem Klima sowie wechselnder Betriebsspannung durchführen		6
17	Sichern von Prozessab- läufen im Einsatzgebiet (§ 3 Nr.17)	 a) technologische Entwicklungstrends, insbesondere bei Materialien, Strukturgrößen und Einsatzfeldern von Halbleiterprodukten, beachten b) Wettbewerbssituation der Produkte, insbesondere in Bezug auf Preise und Qualität, beachten c) Informationen über technische und technologische Bedingungen sowie über Vorgaben der Produktionsplanung beschaffen und an das Team weitergeben d) Produktionsfähigkeit von Anlagen herstellen sowie vorbeugende Instandhaltung zum logistisch richtigen Zeitpunkt im Rahmen des Produktionsablaufes durchführen e) für die rechtzeitige Lieferung benötigter Masken, Medien und Vorrichtungen sorgen sowie Vollständigkeit, Verständlichkeit und Aktualität von Prozessvorschriften kontrollieren f) Beschaffenheit und Menge von Arbeitsstoffen kontrollieren, Proben entnehmen und zur Analyse vorbereiten g) Abgasreinigungs- und Neutralisationsanlagen bedienen und überwachen, pH-Wert von Lösungen bestimmen und Lösungen neutralisieren h) Prozesswasser filtrieren, Aufbereitungsanlagen zur Vollentsalzung und Entkeimung von Prozesswasser bedienen und überwachen, Leitfähigkeit messen i) bei der Durchführung von Prozessschritten vor- und nachgelagerte Prozesschritte berücksichtigen k) Störungen im Prozess erkennen sowie Prozessabläufe durch Nutzung von Eingriffsmöglichkeiten in die Prozesskette sichern l) Vor- und Endprodukte lagern und transportieren 		18

Schwerpunkt: Mikrosystemtechnik

Lfd.	erpunkt: Mikrosystemtech Teil des Ausbildungsberufsbildes	Fertigkeiten und Kenntnisse, die unter Einbeziehung selbstständigen Planens, Durchführens und Kontrollierens zu vermitteln sind	Zeitliche Richtwerte in Wochen im Ausbildungsjahr	
14	Herstellungs- und Montageprozsse (§ 3 Nr.14)	Produktionsanlagen zur Herstellung von Komponenten der Mikrotechnik bedienen und beschicken, Prozesse kontrollieren und überwachen, insbesondere a) Träger für Bauelemente, insbesondere in Dünnschicht- oder Dickschichttechnik, herstellen b) Substrate trennen c) Bauelemente von Mikrosystemen bestücken, kleben, löten und schweißen d) Blech- und Kunststoffteile der Mikrotechnik montieren	1	2 und 3
15	Prozessbegleitende Prüfungen (§ 3 Nr.15)	 e) Substrate montieren, kontaktieren und häusen a) Elemente von Mikrosystemen, insbesondere Sensoren, Aktoren sowie mechanische und optische Funktionselemente, unterscheiden b) Zusammenhänge zwischen den Eigenschaften von Mikrosystemen sowie Prozessparametern, Prozessschritten und Strukturen beachten c) Schichtdicken optisch und mechanisch messen d) Kennwerte von Bauelementen messen und prüfen e) Verbindungen und Justage im Gehäuse kontrollieren f) anhand von Testergebnissen auf Prozessfehler und auf zu verändernde Prozessparameter schliessen 		6
16	Durchführen von Endtests (§ 3 Nr.16)	a) Parametermessungen durchführen b) Endmessungen und Belastungstests durchführen c) Systemabgleich durchführen d) Funktionsanalyse, insbesondere unter Dauerbelastung, wechselndem Klima sowie wechselnder Betriebsparameter durchführen		10
17	Sichern von Prozessab- läufen im Einsatzgebiet (§ 3 Nr.17)	 a) technologische Entwicklungstrends, insbesondere bei Materialien, Funktionen und Einsatzfeldern von Mikrosystemen, beachten b) das Zusammenwirken von Mikrosystemen mit dem Gesamtsystem berücksichtigen c) Wettbewerbssituation der Produkte, insbesondere in Bezug auf Preise und Qualität, beachten d) Informationen über technische und technologische Bedingungen sowie über Vorgaben der Produktionsplanung beschaffen und an das Team weitergeben e) Produktionsfähigkeit von Anlagen herstellen sowie vorbeugende Instandhaltung zum logistisch richtigen Zeitpunkt im Rahmen des Produktionsablaufes durchführen f) für die rechtzeitige Lieferung benötigter Werkzeuge, Bauteile und Medien sorgen sowie Vollständigkeit, Verständlichkeit und Aktualität von Prozessvorschriften kontrollieren g) Beschaffenheit und Menge von Bauteilen und Medien kontrollieren h) bei der Durchführung von Prozessschritten vor- und nachgelagerte Prozesschritte berücksichtigen i) Störungen im Prozess erkennen sowie Prozessabläufe durch Nutzung von Eingriffsmöglichkeiten in die Prozesskette sichern k) Vor- und Endprodukte lagern und transportieren 		18